

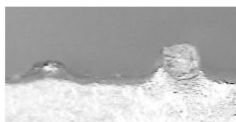
CMP Conditioner REV

CMPコンディショナREV

セラミックス焼結型 CMP コンディショナの特徴

Comparison of bonding materials

	READ	Conventional dressers	
Bonding materials	Ceramics	Transition metals (plated)	Transition metals (brazed)
Hardness (Hv)	1200	600	200
Retention of diamond	◎	△	○
Metal contamination	ND level	Ni	Ni, Cr



セラミックス系の場合、
ダイヤモンドとの結合が非常に強い
Diamond grains are fixed extremely firm in the
ceramic bond.

(ppb)

	SS-W2000	READ (SUS plate)	READ (Resin plate)	Brazed A.	Brazed B.	Plated
Cr	162	152	158	531	1300	195
Fe	51755	52796	51995	53696	55000	67060
Ni	<40	<40	<40	9265	3900	291
Cu	<40	<40	<40	<40	<40	<40
Ag	<20	<20	<20	<20	<20	<20

・セラミックス系の場合、構成元素として遷移金属系元素が含まれていないため、これらの元素の溶出を危惧する必要がない

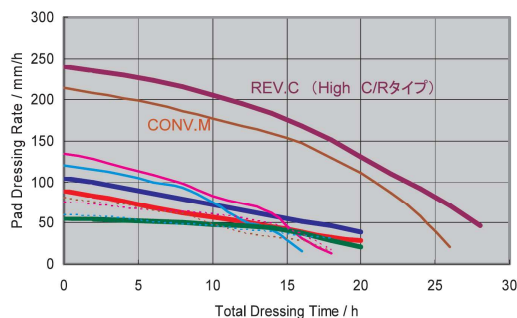
・The ceramic bond does not contain any transition metals. No metal contamination.

ウレタンパッド加工例 ダイヤモンドコンディショナの加工寿命

Urethane Pad Conditioning : the status of diamond

トータル加工時間に対するパッドカットレートの変化 Pad cut rate variance against conditioning time

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Dressing Condition Machine MAT-ARW-6MDS Polishing Pad Rodel Nitta IC1000 Dressing Down Force 6.0 lbf. | <ul style="list-style-type: none"> Dresser Rotation 101 r.p.m Platen Rotation 103 r.p.m Dresser Sweep 10 Sweeps / min Slurry Cabot SS-W2000 + H₂O: 5 wt% 50 ml / min |
|--|---|

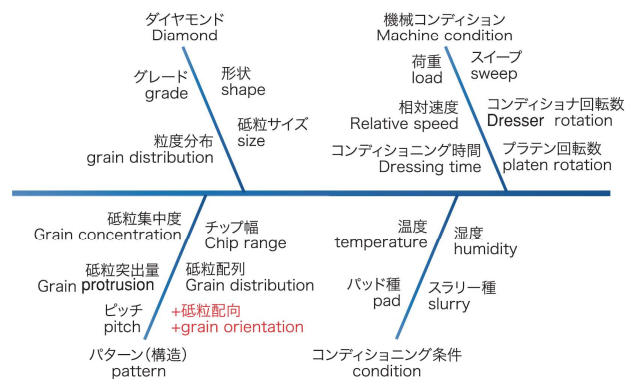


- ・同じ条件下でパッドコンディショニングを実施しても、CMPコンディショナによってパッドのカットレートの変化は異なる
- ・Pad cut rate varies by CMP conditioners even using the same dressing condition.



CMP コンディショナの設計

combined custom design technology and grain orientation technology

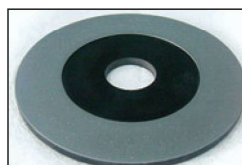


各種プロセスに対応したパッド表面状態の形成が可能
Possible to make a proper pad surface to match each CMP process.

プロセスに応じた最適コンディショニング条件の御提案
READ recommends the most appropriate dressing condition to each process.

コスト要求に応える樹脂台金技術

Resin plate technology which meets the cost demand



コンディショナの平坦度は樹脂台金コンディショナにおいても従来のSUS台金コンディショナと同等の平坦度で御提供可能です。

We can provide the same conditioner flatness as for SUS alloy conditioners even for plastic alloy conditioners.